

东吴证券股份有限公司

关于鸿日达科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币 14.60 元，本次发行募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况说明

公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下，将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金合计 23,687.01 万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）利用其现有厂房实施。

公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月 31 日。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”、“半导体金属散热片材料项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 11 月 30 日。

公司分别于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更原募投项目中“昆山汉江精密连接器生产项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”的部分募集资金用途，用于开展“光通信设备项目”和“半导体封装高端引线框架项目”（以下简称“半导体引线框架项目”），以进一步推进公司在光通信领域、半导体封装高端引线框架领域的布局，提高募集资金的使用效率与投资回报。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	累计已使用募集资金
1	昆山汉江精密连接器生产项目	18,479.24	18,479.24	13,243.76

2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3	汽车高频信号线缆及连接器项目	3,411.20	3,411.20	1,346.46
4	半导体金属散热片材料项目	11,428.17	11,428.17	6,178.28
5	光通信设备项目	7,864.24	7,864.24	-
6	半导体封装高端引线框架项目	11,740.48	9,000.00	-
合计		58,923.33	56,182.85	26,768.50

注 1：以上数据已经审计。

注 2：“半导体封装高端引线框架项目”总投资共计为 11,740.48 万元，具体由募集资金 9,000 万元（含超募资金 7,929.76 万元）、鸿科半导体自有资金 2,740.48 万元构成。

三、募投项目延期具体情况及主要原因

（一）募投项目延期具体情况

结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下，公司决定对募集资金投资项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
昆山汉江精密连接器生产项目	2026 年 3 月 31 日	2026 年 11 月 30 日

（二）本次募投项目延期的原因

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”已完成大部分建设任务，累计投资进度超过 70%。综合考虑下游市场环境变化及公司长期战略发展规划，为进一步提升公司产品的核心竞争力，更好地满足高端制造领域的市场需求，公司在项目建设过程中，对部分产线的工艺设计进行了精细化优化与升级，并同步推进生产线的精准配置与调试。此举旨在确保项目建成后具备更高的生产效能与产品稳定性，保障募投项目的长期可行性与市场适用性。鉴于上述优化工作导致建设周期有所延长，经公司审慎研究论证，并在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资总额的前提下，决定将“昆山汉江精密连接器生产项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 11 月 30 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延

期未改变项目的建设内容、实施主体等，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变更的情况下，将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年11月30日。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，全体委员全票通过，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变更的情况下，将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年11月30日。

六、保荐机构核查意见

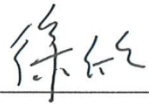
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



徐 欣



李 喆

东吴证券股份有限公司
2016年 4 月 22 日

